

股票代码：300429

股票简称：强力新材

债券代码：123076

债券简称：强力转债

### 常州强力电子新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与强力新材 2024 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 05 月 07 日（星期三）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”小程序
上市公司接待人员姓名	董事长兼总裁：钱晓春先生 独立董事：范琳女士 董事、副总裁兼董事会秘书：倪寅森先生 副总裁兼财务总监：潘晶晶女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：在先进光刻技术研发、新型光刻胶材料开发等方面有哪些布局？ 答：您好，公司研发的光敏性聚酰亚胺（PSPI）应用于半导体先进封装领域，是重布线制程（RDL）的关键材料。公司开发有多款 PSPI 产品，其中高温固化 PSPI 用途广泛，适用于各类封装结构；低温固化 PSPI 适用于 FO-WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结构。目前公司的 PSPI 产品处于给客户送样验证阶段。公司还布局了半导体先进封装用电镀材料，包括电镀铜、镍、锡银，上述电镀材料广泛应用于各类 bumping 工艺，同时适用 2.5D、3D 先进封装制程，目前公司的先进封装用电镀材料处于

客户认证阶段。公司将争取一切资源，积极推进公司先进封装领域材料的客户认证进程，以期尽早给公司带来实际效益，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

2、问：公司在半导体先进封装材料项目上获得了环评批复，该项目的进展情况如何？预计何时能够投产并产生效益，对公司未来营收和利润的贡献预计有多大？

答：您好，该项目目前处于建设阶段。谢谢！

3、问：请问公司计划采取哪些具体措施来降低成本，提升盈利能力？

答：您好，公司计划从以下几个方面来降低成本：（1）采购环节：通过集采方式，开发新供应商，降低原材料成本；（2）生产端：优化生产技术，提高设备利用率；（3）人员方面：优化人员结构，提高员工技能水平；（4）运营管理方面：控制公司营运费用。谢谢！

4、问：在改善经营现金流方面有哪些计划和措施，以保障公司运营资金需求？

答：您好，公司将采取以下措施保障公司运营资金需求：（1）对外，公司将持续优化应收账款管理，充分利用供应商的账期政策，加强与银行等金融机构的沟通协作，优化融资结构，保证通畅的融资渠道；（2）对内，公司将强化资金预算管控，提高库存周转效率，控制成本开支，降本增效。双管齐下保证公司运营资金需求。谢谢！

5、问：各板块营收和利润贡献差异明显，未来公司会重点发展哪个业务板块？对于营收增长缓慢或下滑的板块，有怎样的改进和复苏策略？

答：您好，公司的主营业务包括电子材料（PCB 光刻胶专用电子化学品、LCD 光刻胶专用电子化学品、半导体光刻胶专用电子化学品、OLED 材料等）和绿色光固化材料。公司未来发展仍坚持“深耕主业，开拓新兴”的双

轮驱动策略，对主业各板块坚守既有市场份额，加强与客户的沟通协调，增加客户粘性。同时积极推广新产品、开拓新市场、挖掘新机会。 2024 年度公司实现营业收入 92,408.71 万元，较去年同期增加 15.93%。公司本报告期发生亏损，主要原因为受市场需求及竞争环境影响，公司部分产品市场售价处于低位，毛利下降。本报告期有部分在建工程转入固定资产，利息不再资本化，财务费用增加。报告期内，公司对各类资产进行了减值测试，计提信用减值准备及资产减值准备共计 12,357.32 万元。为优化公司经营管理及应对市场需求的不确定性，2025 年公司经营计划如下：（1）加强市场营销：强化销售及技术支持人员培训，提高业务水平，坚持固旧拓新，加强与客户的沟通协调，坚守既有市场份额，积极推广新产品、开拓新市场、挖掘新机会；（2）坚持研发技术创新：继续保证研发投入，坚持核心技术自主化。以用户需求为导向，深挖市场痛点与机遇，加速产品创新及应用创新；（3）安全优化生产：守好安全合规生产底线，坚持安全环保专业化，树立“品质至上”理念。优化产能资源和产品布局，通过工艺优化提升、精益生产等多种方式，全方位实现降本增效；（4）优化财务与资金风险控制：完善财务制度与作业管理，降低资金成本，优化资本结构和资金分配。通过专业化的财务数据分析，支持公司战略决策和资源配置；（5）完善人才发展建设：落实绩效评价体系，提升工作效率；强化高素质人才队伍，重视梯队建设；重点岗位积极做好高端人才引进和服务保障工作；根据人才结构，提供个性化多类别培训；构建和谐开放的职场环境，保障员工合法权益；增强员工归属感，营造积极向上、团结友爱的企业文化氛围。谢谢！

6、问：公司正在从光刻胶单体供应商向光刻胶体系服务商转型，能否详细介绍一下目前的转型进展？

答：您好，公司是国内少数有能力深耕光刻胶专用电子化学品和绿色光固化材料领域的国家火炬计划重点高新技术企业。公司主要从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品和绿色光固化材料的研发、生产和销售及相关贸易业务。公司坚持围绕“核心技术自主化、产业基础高级化、产业链现代化”生产经营，固旧不守旧，创新向未来。谢谢！

7、问：公司是否有新的业务布局或拓展计划？公司如何实现从现有业务向新业务领域的转型升级？

答：您好，公司除积极开展现有主营业务外，还在积极布局研发新产品。公司研发的光敏性聚酰亚胺（PSPI）应用于半导体先进封装领域，是重布线制程（RDL）的关键材料。公司开发有多款 PSPI 产品，其中高温固化 PSPI 用途广泛，适用于各类封装结构；低温固化 PSPI 适用于 FO-WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结构。目前公司的 PSPI 产品处于给客户送样验证阶段。公司还布局了半导体先进封装用电镀材料，包括电镀铜、镍、锡银，上述电镀材料广泛应用于各类 bumping 工艺，同时适用 2.5D、3D 先进封装制程，目前公司的先进封装用电镀材料处于客户认证阶段。公司将争取一切资源，积极推进公司先进封装领域材料的客户认证进程，以期尽早给公司带来实际效益，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！

8、问：半导体光刻胶光引发剂领域增长迅速，未来是否会继续加大在这一领域的投入？除此之外，公司还有哪些新兴业务布局和发展方向？

答：您好，公司目前半导体光引发剂领域的产品收入占公司营业收入比例较小，公司未来将继续加大在这一领

	<p>域的投入。公司目前在先进封装材料领域的新产品有光敏性聚酰亚胺（PSPI）、先进封装用电镀材料，但目前仍处于客户认证阶段，敬请广大投资者注意投资风险。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2025年05月07日